

功率模块：不同型式选择的解释



内容

1. 一般信息

2. MiniSKiiP®盖的选项

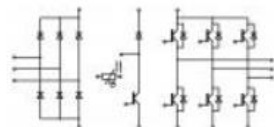
3. 热界面材料

不同型号的解释：一般信息

网上商店所提供的不同型式：

有一系列产品型式让客户选择：

- 用于MiniSKiiP®模块的压接盖类型：标准或薄盖
- 导热涂层材料：导热硅脂或相变材料



SKiiP 11NAB12T4V1

MiniSKiiP® 1

V_{CES} 1200 V

I_{Cnom} 8 A

Part Number: 25231580

Net unit weight: 0.03 kg

Tariff Number: 85412900

Country of Origin: Germany

Manufacturer: SEMIKRON

[datasheet](#)

EUR | USD



Choose variant

- std. lid (6.5mm)
- slim lid (2.8mm)
- std. lid (6.5mm), therm.paste
- slim lid (2.8mm), therm.paste
- no accessories
- with therm.paste only

编号	不同型式的描述	M10	带薄盖 (2.8 mm)
M00	仅功率模块	M11	带薄盖和导热硅脂涂层 P12
M01	带导热硅脂涂层 P12	M20	带标准盖(6.5 mm)
M04	带相变材料 HALA P8	M21	带标准盖和导热硅脂涂层 P12

MiniSKiiP®不同型式选项的解释：盖的选项

- 标准盖：

盖的高度为6.5毫米。

为SMD组件提供充足的空间
(最高为3.5毫米)



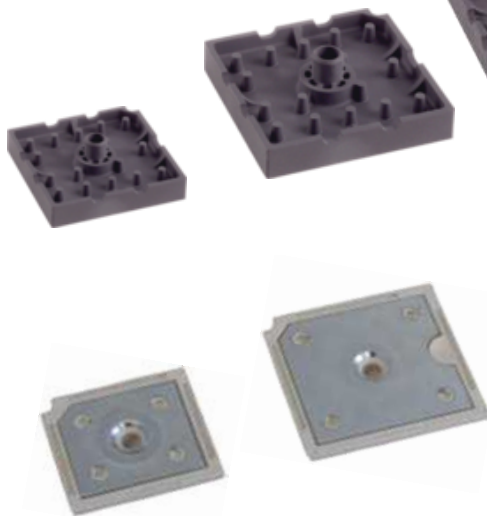
标准盖 6.5 mm



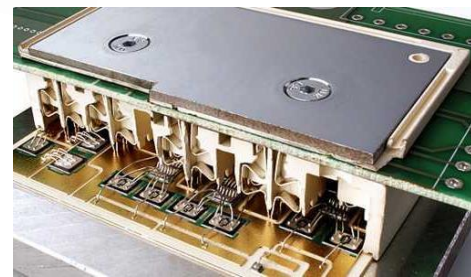
- 薄盖：

盖的高度为2.8毫米。

满足最低高度要求的薄盖
解决方案



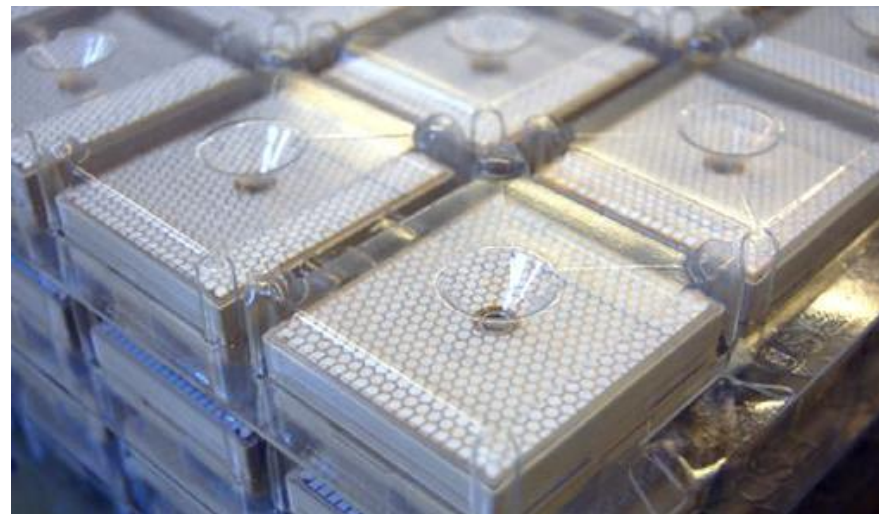
薄盖 2.8 mm



不同型式选项的解释：盖导热涂层材料

- 带导热硅脂涂层 (P12):

导热硅脂涂层的最佳厚度让模块安装到散热器的工序快速和容易



- 带相变材料 (HALA P8):

相变材料具有优良的导电性，应用时是液态，室温下是固体，而且是无硅的。

